

Communiqué de presse

Le 30 juillet 2009

Corning et Soitec s'associent pour développer des substrats avancés pour écrans mobiles à diodes organiques OLED

CORNING, N.Y. et BERNIN, France— La société Corning Incorporated (NYSE:GLW) et Soitec (Euronext Paris), annoncent aujourd'hui la signature d'un accord de collaboration portant sur le développement de substrats en silicium sur verre (SiOG – silicon-on-glass) de haute performance destinés au marché des écrans plats pour produits mobiles. Les deux sociétés vont concentrer leurs travaux sur la technologie des substrats de haute performance pour écrans mobiles à diodes organiques (OLED – organic light-emitting diode).

L'objectif de cette collaboration est de relever les défis rencontrés dans la commercialisation à grande échelle d'écrans de haute qualité avec des coûts optimisés obtenus grâce à la technologie OLED mobile. Ces défis concernent notamment l'uniformité et la mobilité des électrons et la réduction du coût total du système. Pour leur part, les exceptionnelles performances électriques des circuits devraient permettre aux fabricants d'écrans de bénéficier d'une forte intégration et de simplifier les opérations de production.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Soitec, un leader des technologies de transfert de films de silicium et de silicium sur isolant (SOI) utilisées en micro-électronique », déclare Dr. Mark A. Newhouse, senior vice president and director, New Business Development, Corning Incorporated., Ces activités de développement devraient accélérer la disponibilité de nos substrats en silicium sur verre qui permettront la fabrication d'écrans à diodes organiques de haute qualité à un meilleur coût ».

« Cette coopération constitue une avancée naturelle pour les compétences historiques de nos deux sociétés. Ensemble, nous allons créer des substrats de haute performance au meilleur coût pour le marché des écrans plats utilisés dans les produits mobiles », déclare pour sa part André-Jacques Auberton-Hervé, Président du Groupe Soitec. « Outre l'accent mis sur les substrats pour écrans mobiles, ces travaux de co-développement devraient nous permettre d'explorer de nouvelles applications pour des substrats innovants, faisant appel à des films minces semi-conducteurs ou en verre, ce qui élargirait considérablement notre portefeuille de produits ».

Actuellement en cours de développement, la technologie silicium sur verre de Corning est basée sur une mince couche de silicium monocristallin appliquée à un verre d'écran. Cette technologie transforme le verre en un substrat traité et innovant qui se caractérise par une uniformité matérielle et une mobilité électrique exceptionnelles, sur lequel les fabricants d'écrans peuvent appliquer facilement des circuits électroniques. Parmi les premières applications envisagées pour cette technologie figurent les produits mobiles dotés d'un écran de petite ou moyenne dimension.

La technologie Smart Cut™ de Soitec est utilisée pour transférer des très fines couches de matériau (comme du silicium) sur une autre surface. Cette technique est utilisée pour la fabrication de plus de 90 % des plaques SOI utilisées par l'industrie micro-électronique. Le savoir-faire et les capacités industrielles sans équivalent de Soitec, complétés par son aptitude à améliorer en permanence ses produits et procédés pour satisfaire à des exigences strictes et en constante évolution, est essentiel pour accélérer la mise sur le marché de substrats SiOG pour de nouveaux marchés.

A propos de Corning Incorporated

Corning Incorporated (www.corning.com) est le leader mondial en verres et matériaux céramiques spéciaux. Forte de plus de 150 années d'expérience en sciences des matériaux et en ingénierie des procédés, la société crée et fabrique des composants clés pour les systèmes de haute technologie utilisés dans les secteurs de l'électronique grand public, du contrôle antipollution mobile, des télécommunications et des sciences de la vie. Parmi nos produits figurent des substrats en verre pour téléviseurs à cristaux liquides (LCD), écrans d'ordinateur et ordinateurs portables ; des filtres et substrats en céramique pour les systèmes antipollution mobiles ; des fibres optiques, des câbles, des matériels et des équipements pour réseaux de télécommunications ; des bio-capteurs optiques pour la recherche pharmaceutique, ainsi que d'autres solutions avancées d'optique et de verres spéciaux pour de nombreuses industries dont les semi-conducteurs, l'aéronautique, la défense, l'astronomie et la métrologie.

À propos de Soitec

Soitec (www.soitec.fr) est le leader mondial dans la fourniture de substrats innovants pour l'industrie microélectronique de pointe. Le groupe produit une gamme étendue de matériaux avancés, notamment les plaques de silicium sur isolant (SOI) basées sur sa technologie Smart Cut™, la première application à fort volume de cette technologie. La technologie SOI apparaît aujourd'hui comme la plate-forme du futur, ouvrant la voie à la production de puces plus performantes, plus rapides et plus économiques. Aujourd'hui, Soitec fabrique plus de 80% des plaques de silicium sur isolant utilisées mondialement. Basé à Bernin, en France, où se trouvent deux unités de production à fort volume, Soitec possède des bureaux aux USA, au Japon et à Taiwan, ainsi qu'un nouveau site de production à Singapour.

Relations Presse – H&B Communication

Marie-Caroline Saro – Tel. +33 (0)1 58 18 32 44 – Mob. +33 6 70 45 74 37

Anne Hardy – Tel. +33 (0)1 58 18 32 30 – Mob. +33 6 13 56 23 96

mail : mc.saro@hbcommunication.fr